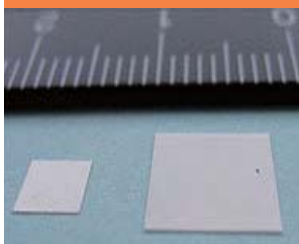


電子部品・デバイスの実装

切削加工



●ダイヤモンド単結晶とその関連素材の製造・販売

株式会社イーディーピー

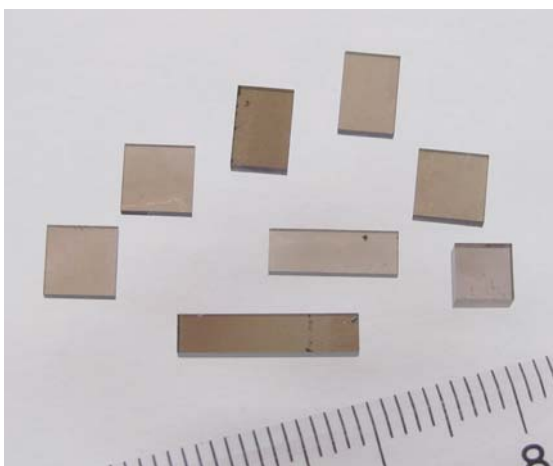
▶TEL: 072-646-8858 FAX: 072-646-8868

▶URL: <http://www.d-edp.jp>

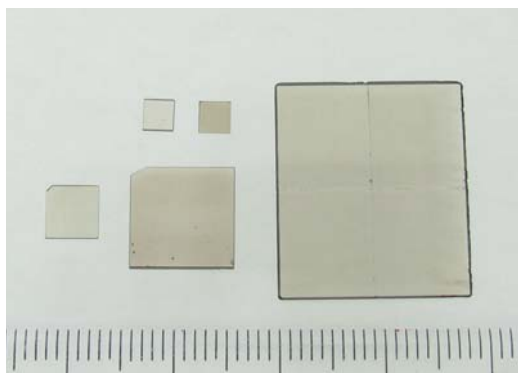
独自製法で、ダイヤモンド単結晶の大型化・量産化を実現

ここが
スゴイ!

産総研ベンチャーの第100号に認定されるイーディーピー。気相合成法により、低コストで高純度のダイヤモンド結晶を高速成長させる製法を確立。種結晶からの分離技術で薄板の大量生産を可能とし、結晶の大型化に成功した。切削工具など長尺刃用、研究用基板、さらには将来の電子制御用デバイスとしての利用が期待されている。



最長切り刃は12mmを可能とする工具用素材



研究用基板

事業概要と躍進の契機

ダイヤモンドの可能性を拓ける、産総研ベンチャーの第100号企業

独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）が開発したダイヤモンド製造技術を核にして、産総研ベンチャーの第100号として活動を開始。夢の材料ダイヤモンドの可能性を拓くために、これまでなかった単結晶素材を提供している。天然や超高压法では得られない12mmの大型単結晶、長辺が20mmのモザイク結晶を実現。0.1mm以下の薄板単結晶も作成できる。いずれも不純物が少なく良質な結晶で品質制御も可能である。既存の単結晶に比べて安価で、安定した特性を得られることから、実用化・市場化を目指してベンチャー設立に至った。

会社の強み・主力商品など

工具用素材や研究用基板など実用化の用途が広がる

ダイヤモンドの様々な応用展開を目指し、研究成果を社会へ送り出す実用化・市場化を支えるイーディーピー。企業での製品開発、事業運営の経験をいかし、世の中の人々が欲している製品ニーズを的確に捉えつつ、ターゲット市場に求められる商品化に取り組んだ。品質とともに、従来製品に比べて価格競争力にも優れることから、切削・耐摩工具用素材、研究用基板などに採用されており、放熱材料としての応用製品分野にも対応する。

今後の事業展開

次世代半導体材料として期待される大型ウエハの実現を目指す

次世代の半導体材料として有力視されるダイヤモンドデバイス。それに向けた1~2インチ、3インチといった大型ウエハの開発を目指している。また、高品質で無色の光学用結晶、大型多結晶板など、将来の製品開発に向けた挑戦を続けていく意向である。

●企業プロフィール

〒567-0005 茨木市五日市1-7-24
代表取締役社長 藤森直治
設立: 2009年(平成21年)
従業員数: 4名
資本金: 5,450万円

企業メッセージ

ダイヤモンドの可能性はまだまだ拡がりを見せています。世の中のニーズを知り、ユーザーの声を聞きながら、新しい提案を行って行く。次のステップへ進むために挑戦を続けていきたいと考えています



代表取締役社長 藤森直治